

证券代码：600460

证券简称：士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	电话会议交流
调研时间	2022年8月22日 20:00—22:00
调研机构名称 (排名不分先后)	中信证券、方正证券、开源证券、东北证券、中金公司、民生证券、光大证券、财通证券、天风证券、中信建投、华泰证券、西南证券、国信证券、兴业证券、海通证券、美银证券、中邮证券、西部证券、平安证券、中泰证券、华创证券、首创证券、世纪证券、万联证券、长城证券、浙商证券、华融证券、德邦证券、江海证券、万和证券、海通国际、景顺长城基金、博时基金、银河基金、易方达基金、富国基金、华夏基金、天弘基金、诺德基金、汇添富基金、嘉实基金、广发基金、交银施罗德基金、申万菱信基金、新华基金、华富基金、银华基金、大成基金、长信基金、中信建投基金、南方基金、中邮基金、华融基金、先锋基金、永赢基金、西部利得基金、东方阿尔法基金、融通基金、泰信基金、德邦基金、华富基金、博道基金、兴华基金、宝盈基金、嘉实基金、平安基金、东吴基金、中金基金、华宝基金、国金基金、兴业基金、达诚基金、中信保诚基金、鹏华基金、工银瑞信基金、建信基金、鹏扬基金、国融基金、富荣基金、华宝兴业基金、华泰柏瑞基金、惠升基金、中银基金、华商基金、浙商基金、国寿安保基金、光大保德信基金、民生加银基金、摩根士丹利华鑫基金、汇丰晋信基金、安信基金、东方基金、长城基金、国投瑞银基金、长安基金、中航基金、汇泉基金、益民基金、新百信基金、九泰基金、华润元大基金、中加基金、金元顺安基金、山石基金、恒越基金、源峰基金、创金合信基金、易米基金、中欧基金、太平基金、国寿安保基金、国教基金、泰达宏利基金、国泰基金、弘毅远方基金、万家基金、招行资管、人保资产、人寿资产、新华资管、泰康资产、太平资产、高毅资产、淡水泉、高盛资管、花旗银行、瑞士信贷、贝莱德、JP Morgan 等 500 余位机构投资者。
公司接待人员	董事会秘书、财务总监陈越先生
投资者关系活动主要内容介绍： 一、公司 2022 年上半年经营情况简介 2022 年上半年，受地缘政治冲突、疫情、通胀等多种因素的影响，全球经济增长进一步放缓。全球半导体行业经历了 2021 年高速增长后，2022 年上半年增速开始回落，且结构性分化较为明显：一方面，与普通消费电子相关的产品需求较为疲软，另一方面与汽车、新能源等相关的产品需求较为旺盛；在国家政策的引导下，国产芯片进口替代的进程明显加快。	

公司上下紧紧围绕董事会于年初提出的“持续提升综合能力，发挥 IDM 模式的优势，聚焦高端客户和高门槛市场；重点瞄准当前汽车和新能源产业快速发展的契机，抓住国内高门槛行业和客户积极导入国产芯片的时间窗口，利用我们有多条不同尺寸硅芯片产线和化合物产线的特点拓展工艺技术与产品平台”这一指导方针，继续在特色工艺平台建设、新技术新产品开发、与战略级大客户合作等方面加大投入，产品结构调整的步伐进一步加快。

2022 年上半年，公司营业总收入为 418,494 万元，较 2021 年同期增长 26.49%；公司营业利润为 68,761 万元，比 2021 年同期增加 46.23%；公司利润总额为 68,671 万元，比 2021 年同期增加 46.31%；公司归属于母公司股东的净利润为 59,934 万元，比 2021 年同期增加 39.12%。

2022 年上半年，公司集成电路的营业收入为 13.53 亿元，较上年同期增长 20.80%；分立器件产品的营业收入为 22.75 亿元，较上年同期增长 33.13%；发光二极管产品的营业收入为 3.64 亿元，较上年同期增加 23.75%。

2022 年上半年，公司子公司士兰集成公司基本处于满负荷生产状态，总计产出 5、6 吋芯片 127.66 万片，比上年同期增加 4.43%；士兰集昕公司总计产出 8 吋芯片 31.14 万片，比上年同期减少 1.61%，实现营业收入 60,726 万元，比上年同期增加 14.16%；成都士兰公司总计产出各尺寸外延芯片 35.87 万片，比上年同期增加 10.81%；成都集佳公司已形成年产智能功率模块（IPM）1.3 亿只、年产工业级和汽车级功率模块（PIM）150 万只、年产功率器件 10 亿只、年产 MEMS 传感器 2 亿只、年产光电器件 4,000 万只的封装能力；重要参股公司士兰集科公司 12 吋线总计产出芯片 22.17 万片，较上年同期增加 287.58%；士兰明镓公司已建成月产 4 吋 LED 芯片 7.2 万片的产能。

2022 年上半年，公司电路和器件成品的销售收入中，已有接近 70% 的收入来自白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场。公司将抓住芯片国产替代的有利时机，持续推动满足车规级和工业级要求的器件和电路在各生产线上量，持续推动士兰微电子整体营收的较快成长和经营效益的提升。

今后公司技术和产品平台的升级主要聚焦在五个方面：第一，先进的车规和工业级电源管理产品（芯片设计、芯片工艺制造）；第二，车规和工业级功率半导体器件与模块技术（含化合物 SiC 和 GaN 的芯片设计、制造、封装）；第三，MEMS 传感器产品与工艺技术（芯片设计、芯片工艺制造和封装）；第四，车规和工业级的信号链（接口、逻辑与开关、运放、模数\数模转换等）、混合信号处理电路（含芯片设计和芯片制造）；第五，光电系列产品

（发光二极管及其它光电器件的芯片制造及封装技术）。

经过 20 多年的发展，公司已成为以“设计制造一体”（IDM）模式为主要经营模式的综合性半导体产品公司。公司长期发展目标是以国际上先进的 IDM 大厂为学习标杆，成为具有自主品牌，具有国际一流竞争力的综合性的半导体产品供应商。

二、投资者的主要问题

问题 1：2022 年半年报非经常性损益中 1.2 亿元投资收益具体是什么项目？

回答：主要系公司参股的显能科技今年上半年在科创板上市后估值增加，本期确认公允价值变动损益 1.27 亿元。

问题 2：2022 年半年报提到公司目前具备月产 7 万只汽车级功率模块的生产能力，年底能到多少？

回答：受原材料供应紧张和设备延期交货以及工艺平台转移的影响，车规模块上量比原计划要延后一个季度。预计今年年底月产能达到 10 万只。

问题 3：今年全年 100 亿的营收目标是否有调整？

回答：到今天为止这个目标没有改变，我们还是会积极努力去实现。今年上半年的执行情况给公司带来了不小的压力。虽然消费电子需求疲软，但公司在消费电子领域基本都是与大客户合作，目前头部客户的订单比较稳定。此外，今年上半年更多的还是由于公司自身芯片供应不足。目前设备、材料以及工艺平台转移等问题都在逐步解决，下半年我们还是会努力争取好的成绩。

问题 4：2022 年半年报中分立器件业务能否具体拆分，如 IGBT、MOS 等占比情况？

回答：今年上半年分立器件业务同比增长 33.13%，其中占比较高的是 MOS。公司正在加大拓展器件成品业务，各个市场份额占比都在提升。

问题 5：公司 IPM 业务目前在家电领域的市占率以及下半年对 IPM 业务的展望？

回答：今年上半年 IPM 业务受到公司自身芯片供应不足的影响，增速放缓。对士兰微来说，目前处于国产替代的好时机，白电领域对 IPM 需求量非常大。尽管短期家电市场需求疲软，但头部企业还是比较稳定；公司目前在白电市场的份额还不高，有提升的空间；海外大厂的交期仍然比较长，因此大客户会有供应链稳定的考量。下半年随着产能进一步释放，我们希望在白电以及其他领域有更好的表现，包括车用空调等市场。未来 IPM 增速会放缓，但仍然有较大的成长空间。

问题 6: IGBT 汽车主驱模块今年全年出货量指引? 新客户导入的进展情况?

A: 目前已经有多家国内客户完成认证。具体出货量暂时无法提供数据。公司正在逐步解决芯片产能释放、封装产能释放、供应链保障等问题, 加快车规模产能建设。

问题 7: 公司 SIC 产品目前进展情况?

回答: 目前 SIC MOSFET 已给客户送样; SiC SBD 结合 IGBT 产品已给客户小批量供货。

目前最缺的还是 SIC MOS 产品, 公司产品性能可以对标国际大厂。我们正在加快建设 SIC 产线, 规划产能为月产 1.2 万片 6 吋片, 建设周期 3 年。如果国内衬底材料能突破, 则项目进展可以加速实现, 目前来看机会较大。

问题 8: 公司各条产线分别适合做什么样的产品?

回答: 公司产线的产品主要围绕前述五个方面的技术和产品平台。5 吋线有双极性的 1~2um 的平台, 6 吋线为 0.5~0.8um 的平台, 5、6 吋线主要做平面类产品, 有很多高端产品可以制造; 8 吋线有 0.35/0.18/0.13um 三个重要的工艺平台, 可以覆盖工业、汽车等大部分应用场景; 8 吋线还有传感器产品, 加速度计产品目前成长性不错, 陀螺仪、六轴惯性单元等产品空间也很大; 12 吋线为 90 纳米制程, 8 吋和 12 吋都可以做沟槽型功率半导体产品。

问题 9: 公司去年下半年高门槛业务的收入占比是 20~30%, 今年上半年高门槛业务的收入占比是 70%, 具体是如何实现的?

回答: 今年和去年的统计口径不一样。这个数据是指电路和器件成品业务, 不包括直接销售器件芯片和 LED。如果包括美卡乐高端 LED 器件成品在内, 合计约为 27~28 亿, 占整体营收的比例约为 70%。目前新能源汽车和光伏的占比还不够, 但后续应该会很快提升。

问题 10: 士兰集科 12 吋线产能爬坡情况? 上半年面临的影响因素什么时候会缓解?

回答: 士兰集科 12 吋线目前月产 4.5 万片, 今年年底目标是月产 6 万片, 同时还有技术平台的转移和提升。公司正在加快高端产品的导入, 做好产品结构调整。IGBT 月产能今年上半年已经达到 5K, 另有 5K 产能即将释放, 配套的材料、设备等问题也在逐步解决。今年年底 IGBT 月产能预计达到 2 万片。公司目前重点是围绕高门槛市场和高端客户、汽车和新能源市场, 利用不同产品线的工艺特点打好组合拳。

问题 11: 今年上半年士兰集科公司库存增加较多, 士兰集科公司是不是也面临同样的问题?

回答：士兰集科公司和士兰集昕公司都是士兰微的芯片供应商。士兰集科公司不在合并报表范围之内。短期由于处于产品结构调整的转换期，会有一些的压力，主要体现在存货的增加。从士兰集昕公司存货的组成来看，今年上半年产品结构提升调整导致原材料、在产品、产成品都增加了，其中在制品投入增加较多；下半年随着车规和光伏产品的放量，将进一步优化产成品结构。

问题 12：士兰集昕公司去年下半年净利润已扭亏为盈，今年上半年又亏损的原因什么？

回答：净利润转正并不是衡量利润稳定的指标。士兰集昕公司目前还处于产品结构调整的过程中。

问题 13：公司在存货方面是否存在减值风险？

回答：减值风险不大。今年上半年计提减值主要为发光二极管芯片，因为发光二极管芯片市场敏感度较高，公司计提减值准备的原则也相对比较严格。

问题 14：公司光伏产品的进展情况？

回答：公司光伏产品采用的是 V 代 IGBT。明年的重点除了加大 IGBT 单管供应外，我们还会大量推广光伏逆变模块。